

6/28

宽能带功率半导体测试与3DIC应用(3)

近年来5G通讯、电动车、储能、电池、工控设备等应用大增，宽能带半导体(WBG)材料，如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)，为产业带来更高效能、更轻巧且稳定的半导体组件，非常适合高功率转换以及测试制程效率的改善。筑波科技与Teradyne ETS产品线合作，提供线性、电源和汽车电子测试，符合客户需要的大批量量产、质量提升及加快上市时间之半导体测试设备系统、软/硬整合方案服务。

筑波科技在异质材料界面、Wafer材料分析MA、3DIC故障瑕疵分析FA，已有很好的测试方案经验，可增强高阶封装(TSV、Flip-Chip等)半导体产业的研发质量与生产效率的提升，本次研讨会将从WBG功率IC/module及3DIC测试技术等实务分享。

我们邀请您与筑波科技专业团队就相关议题和技术交流！欢迎宽能带半导体及3DIC产业领域的厂商先进主管报名参加。

Time	Topic	Speaker
PM 1:00~1:30	Registration 报到登记	
PM 1:30~1:40	Welcome 致欢迎词	Richard Hsieh APAC Sales VP, Teradyne
		Steve Hsu President, ACE
PM 1:40~2:10	Teradyne Eagle System introduction Practice Eagle 系统实务介绍	Eric Syu BD Manager, ACE
PM 2:10~2:40	Past to Present: GaN is Now a True Game Changer	JJ Liao Director of Test Operations, Canada GaN System
PM 2:40~3:10	Brief Advanced 3DIC Package Technical Trend and Solutions 简述3D 半导体封装技术趋势及方案	Dr. Chih Chen MSE. Department Professor, NYCU
PM 3:10~3:40	Tea Break 中场休息&方案展示	
PM 3:40~4:00	Brief Compound Materials Test Solution 化合物半导体异质材料测试方案	Antony Hsu RD Project Engineer, ACE
Workshop Group		
PM 4:00~4:10	A: Eagle System Introduction (Eagle 系统测试展示介绍)	Teradyne/ACE
PM 4:10~4:20	B: EOTPR-3DIC Advanced Package Failure Analysis (FA 展示介绍)	Teraview/ACE
PM 4:20~4:30	C: SiC/GaN Wafer 及材料 MA 展示介绍	ACE
PM 4:30~4:40	D: 半导体整合测试及设备服务介绍	ACE
PM 4:40~5:00	Q&A 会后讨论	

活动日期: 2022年6月28日(二) PM1:00 – PM5:00
 活动地点: 线上直播 (VIP邀请ONLY)
 报名方式: Ken Lin: 15150183920 (华东/华北)
 Fred Huang: 18666826750(华南/华西)
 在线报名: http://register.acesolution.com.tw/2022_ACE_Teradyne_ETS

林总监



黄总监



手机扫码报名

TERADYNE TeraView



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co.,Ltd.